



XYZ
RESEARCH

2024

专业
深度

北京研精毕智信息咨询有限公司

中国多媒体智能终端芯片和系统级
解决方案设计开发市场
竞争格局分析

CONTENTS 目录

一、行业发展背景

二、市场竞争格局

三、头部企业分析



多媒体智能终端芯片和系统级解决方案设计开发指根据下游客户需求，提供多媒体硬件用SoC芯片的设计开发服务；所设计的芯片主要应用到多媒体终端，如智能机顶盒、智能电视、智能音箱等设备中，在设备中充当“大脑”的功能；在我国政策扶持、产业链逐渐完善、下游需求量不断增长等因素的驱动下，该行业发展态势向好。

国家政策扶持

- ✓ **国家层面：** 出台了一系列政策措施来促进行业增长，包括**税收优惠、研发资金支持、市场准入便利化**等，旨在鼓励企业加大研发投入，提升自主创新能力，以及推动产业升级和结构调整。
- ✓ **地方政府：** 根据本地产业发展现状，提供一些定制化的扶持措施，比如**设立产业基金、提供研发场地**等，以吸引和培育更多的芯片设计企业在本地发展。

产业链逐渐完善

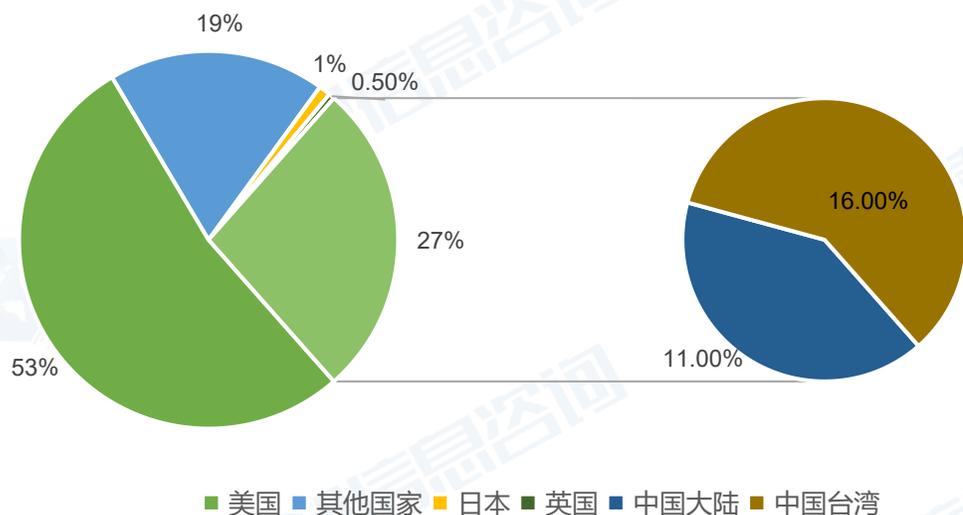
- ✓ **芯片设计行业：** 芯片设计行业是一个**知识密集型领域**，它涉及到将系统、逻辑与性能的设计要求转化成具体的物理版图，这一过程包括前端设计（逻辑设计）和后端设计（物理设计），是一个高度复杂的专业技术过程。
- ✓ **芯片企业：** 目前行业内的芯片企业多采用Fabless模式，与晶圆制造、封装测试等产业链后端环节紧密合作，确保芯片产品的及时供给和高质量完成。**芯片设计行业与制造、封装测试、销售等其他产业链环节的协同效应能够提高整体效率，降低成本，加速产品的上市时间，对行业发展有积极作用。**

下游需求量增长

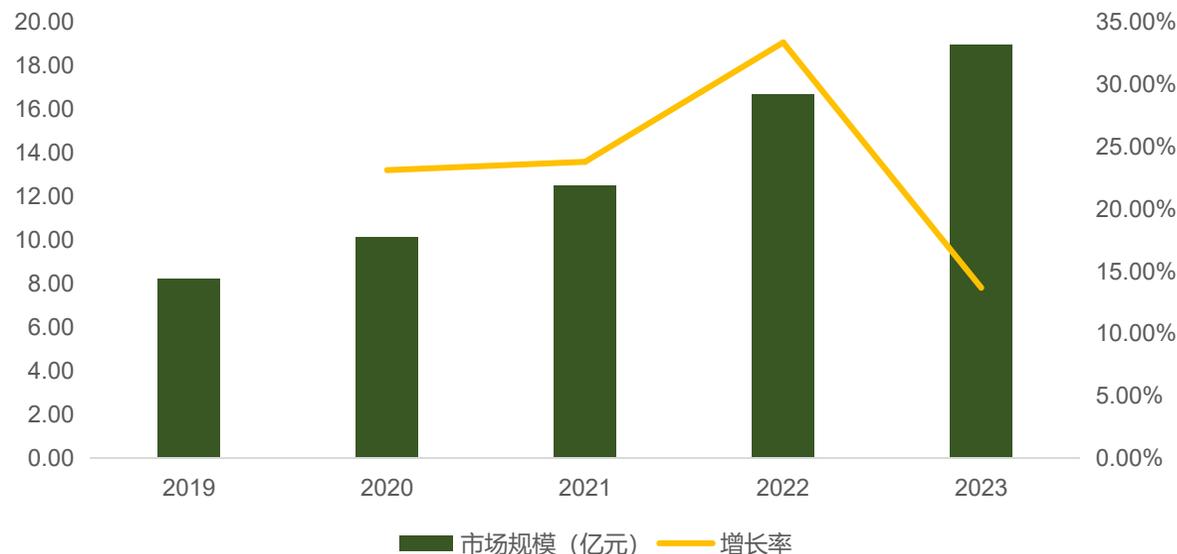
- ✓ **智能机顶盒：** 全球机顶盒出货量从2019年的3.26亿台增长至2023年3.51亿台，处于**持续稳定增长状态**。
- ✓ **智能电视：** 2019年至2023年中国大陆智能电视销售量平稳，维持在4-5千万台的销售水平。
- ✓ **智能音箱：** 智能音箱规模在近几年发展迅速，从2017年开始的一百多万的年出货量到2023年已经达到了超过2500万台的出货量，今后随着智能家居领域中智能化的深入，**智能音箱的需求有望继续受到需求刺激增长。**

中国多媒体智能终端芯片和系统级解决方案设计开发行业的发展起步较晚，但各方面的利好条件使得该行业保持快速增长趋势，目前我国大陆地区和台湾地区的市场占有率已经达到27%，仅次于美国居全球第二名。

全球多媒体智能终端芯片和系统级解决方案设计开发竞争格局 (2023年)



中国多媒体智能终端芯片和系统级解决方案设计开发市场规模及增速 (2019-2023年)

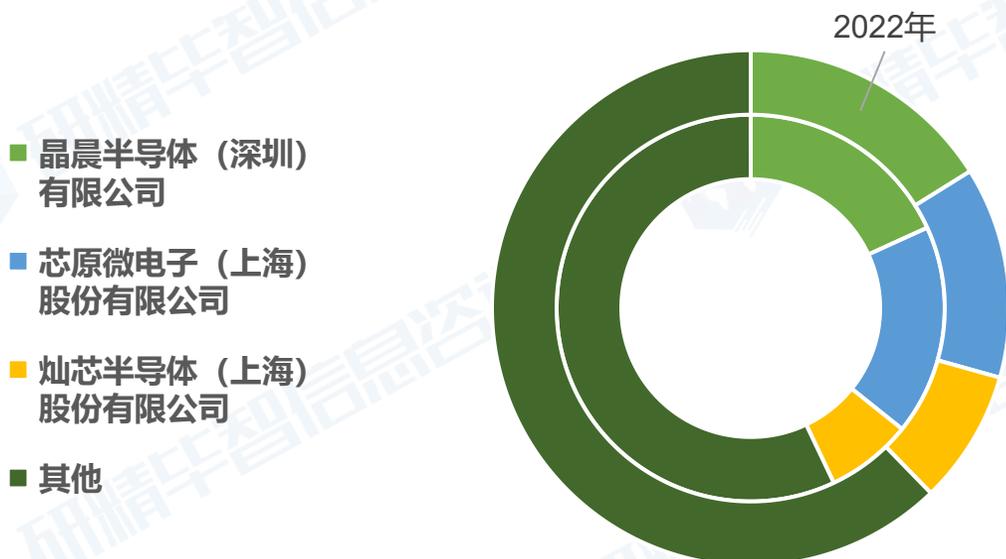


- 全球多媒体集成电路设计行业长期保持增长势头，市场较为集中，美国处于全球领先地位，市场份额高达53%，我国台湾地区占16%，大陆地区占比11%，欧洲和日本分别为2%和1%。
- 我国集成电路设计开发产业虽起步较晚，但凭借巨大的市场需求、稳定的经济发展和有利的政策环境等诸多优势条件快速发展，**现已成为全球集成电路设计行业市场增长的主要驱动力。**

近年来伴随国家政策扶持，下游市场需求增多等因素影响，我国多媒体智能终端芯片和系统级解决方案设计开发市场规模保持持续上涨的趋势，2022年到2023年年增速达到14%，**从长远来看，未来市场规模将呈总体上升趋势。**

中国多媒体智能终端芯片和系统级解决方案设计开发行业市场集中度较高，通常由具有较强研发能力和市场影响力的公司主导，行业头部三家企业市场规模占比约为40%。

中国多媒体智能终端芯片和系统级解决方案设计开发
市场竞争格局：2022年（外）-2023年（内）



- ✓ **市场集中度：**中国多媒体智能终端芯片和系统级解决方案设计开发行业属于知识密集和技术密集的典型高新技术产业，竞争格局较为集中，市场集中度较高。2023年，top 3企业产值占比约为40%。
- ✓ **头部企业：**多媒体智能终端芯片和系统级解决方案设计开发行业作为芯片设计开发的一个细分行业，竞争企业相对全国芯片厂商较少。由于该行业需要大量的研发投入和技术创新，通常由具有较强研发能力和市场影响力的公司主导。
- ✓ **竞争格局：**晶晨半导体（深圳）有限公司多媒体智能终端芯片和系统级解决方案设计开发业务收入在国内市场份额约为16%，处于全国该行业的领导地位。排名第二的是芯原微电子（上海）股份有限公司，2023年该业务市场份额约为13%。灿芯半导体（上海）股份有限公司排名第三，市场份额占比为8.39%。相比2022年，2023年晶晨半导体和芯原微电子的市场份额小幅下降，而灿芯半导体市场份额有所提升。

晶晨半导体（深圳）有限公司于2014年在深圳成立，是以多媒体智能终端集成电路芯片设计开发服务为主要业务的高新技术企业，具有较强的SoC芯片设计研发能力，居行业领导地位。



公司名称：晶晨半导体（深圳）有限公司

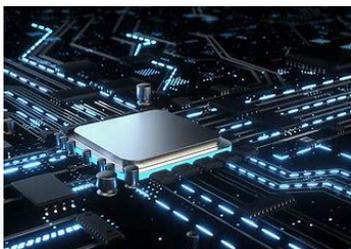


成立时间：2014年



公司总部：深圳

主营业务：晶晨半导体（深圳）有限公司的主营业务为芯片开发服务、集成电路设计技术服务、OTT、IP机顶盒、智能电视和智能家居产品。



➤ 芯片技术开发服务

- 超高清多媒体编解码和显示处理
- 内容安全保护
- 系统IP等核心软硬件技术开发
- 帮助客户实现成本、性能和功耗优化的需求
- 提供多种系统级解决方案



➤ OTT、IP机顶盒、智能电视和智能家居产品系统等高清多媒体解决方案

- 智能机顶盒
- 智能电视
- 音视频系统终端
- 无线连接及车载信息娱乐系统
- 提供多媒体SoC芯片和系统级解决方案

竞争优势

- **技术实力：**晶晨半导体（深圳）有限公司主要研发领域为多媒体智能终端芯片，在此领域的芯片设计开发中拥有精湛的技术和行业领先的创新能力，目前已经拥有**79项有关多媒体SoC芯片的专利**，技术实力深厚，通过将芯片设计方法学与物理结构相结合进行芯片设计，帮助客户高效率、低风险地完成芯片设计和开发。公司能够从芯片设计环节的任一节点介入并完成余下的全部设计工作，最终高效、低风险地完成芯片设计，提高芯片一次流片成功率。
- **客户资源：**主要向**晶晨半导体（上海）股份有限公司、Amlogic Co., Limited、Yeker Information Technology C0.,Ltd**等国内外多媒体芯片头部企业提供多媒体芯片设计开发服务，再由后者进行销售。
- **企业荣誉：**公司是经过认证的高新技术企业和“**专精特新**”中小企业。
- **经营模式：**公司通过积累的芯片设计开发技术和系统级解决方案为客户提供一站式芯片定制服务，而产品的终端销售则由客户自身负责。该种经营模式使得**公司集中力量于自身最为擅长的技术授权和研发平台输出，市场风险和库存风险压力较小。**

芯原微电子（上海）股份有限公司是一家专注于集成电路设计的高新技术企业，主要涉及芯片设计、半导体IP授权以及定制化芯片业务，服务于移动通信、物联网、人工智能、消费电子、多媒体智能终端和汽车电子等领域。



公司名称：芯原微电子（上海）股份有限公司

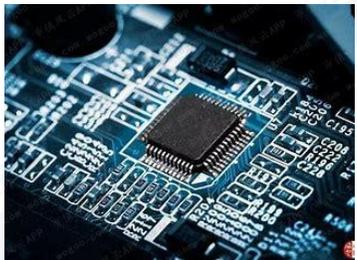


成立时间：2001年



公司总部：上海

主营业务：芯原微电子（上海）股份有限公司的主营业务为一站式芯片定制解决方案和处理器 IP、1,500 多个数模混合 IP 和射频 IP 处理器 IP



➤ 一站式芯片定制解决方案

- 高清视频、高清音频及语音、车载娱乐系统处理器
- 视频监控
- 物联网连接、智慧可穿戴
- 高端应用处理器
- 视频转码加速、智能像素处理



➤ 处理器 IP

- 自主可控的图形处理器 IP
- 神经网络处理器 IP
- 视频处理器 IP
- 数字信号处理器 IP
- 图像信号处理器 IP
- 显示处理器 IP 智能电视

竞争优势

- **技术实力：**芯原微电子（上海）股份有限公司在**传统 CMOS、先进 FinFET 和 FD-SOI 等全球主流半导体工艺节点上都具有优秀的设计能力。**在先进半导体工艺节点方面，公司已拥有 14nm/10nm/7nm/5nm FinFET 和 28nm/22nm FD-SOI 工艺节点芯片的成功流片经验。公司不断积累先进制程芯片设计经验，目前已实现 5nm 系统级芯片（SoC）一次流片成功，多个 5nm 一站式服务项目正在执行。
- **客户资源：**主要客户包括**芯片设计公司、IDM、系统厂商、大型互联网公司、云服务提供商等。**
- **IP授权服务：**从半导体 IP 销售收入角度，芯原微电子（上海）股份有限公司是 2021 年**中国大陆排名第一、全球排名第七的半导体 IP 授权服务提供商**，在全球排名前七的企业中，芯原的 IP 种类排名前二。2020 年和 2021 年，芯原的知识产权授权使用费收入均排名全球第四。

灿芯半导体（上海）股份有限公司是一家提供一站式定制芯片及IP的高新技术企业，为客户提供从芯片架构设计到芯片成品的一站式服务，近年市场占有率不断提升。



公司名称：灿芯半导体（上海）股份有限公司



成立时间：2008年



公司总部：上海

主营业务

芯原微电子（上海）股份有限公司的主营业务包括芯片设计业务和芯片量产业务。其中芯片定义、IP 工艺选型及授权、架构设计、前端设计和验证、数字后端设计和验证、可测性设计、模拟电路设计和版图设计、设计数据校验、流片方案设计高清视频、高清音频及语音、车载娱乐系统处理器。

竞争优势

- **技术实力**：灿芯半导体（上海）股份有限公司拥有较为丰富的高性能 IP 储备以及与工艺高度结合的完整设计服务能力，灿芯半导体（上海）股份有限公司能够对芯片物理设计、封装设计及 PCB 板级设计的信号及电源完整性进行全链路仿真及评估，有效减少了封装设计的迭代次数，缩短了客户产品上市时间。
- **合作伙伴**：与中国大陆技术最先进、规模最大的专业晶圆代工企业拥有战略合作关系，代表着公司是中国大陆实现领先的“自主、安全、可控”设计服务企业之一。
- **竞争壁垒**：灿芯半导体（上海）股份有限公司为客户提供一站式芯片定制服务并转化为客户品牌的芯片产品被广泛应用于物联网、工业控制、汽车电子、高性能计算等众多产业领域中，满足了不同场景差异化、个性化需求，建立了较强的竞争壁垒。
- **国外市场**：多年来，灿芯半导体（上海）股份有限公司积极参与全球竞争，吸引并服务了众多境内外知名客户，在全球集成电路设计服务产业竞争中占据了重要位置。



北京研精毕智信息咨询有限公司（中文简称“北京研精毕智”，英文简称“XYZResearch”）

——国内领先的行业及企业研究服务供应商——

服务号



订阅号



分析师



联系方式

电 话: 010-53322951
+86-18480655925
E-mail: info@xyz-research.com
sales@xyz-research.com
官 网: <https://www.yjbzr.com/>
地 址: 北京市海淀区中关村E世界财富中心
C座879



分析师声明

负责本研究报告的分析师在本报告中所采用的数据均来自合规渠道，报告的观点、逻辑和论据均为分析师本人研究成果，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

公司声明

本报告的著作权归北京精毕智信息咨询有限公司(简称为“研精毕智”)所有。本报告是研精毕智研究与统计成果，所载的观点、结论和建议仅代表行业基本状况，仅为市场及客户提供基本参考。

本报告调研方法主要是桌面研究、行业访谈等，结合公司内部逻辑算法，通过定量和定性分析分析，客观阐述行业的现状，科学预测行业未来的发展趋势。

我们力求报告内容客观、公正，但受到调研方法及调查资料收集范围的局限，本报告所述的观点、数据并不一定完全准确。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式篡改、复制和发布。如引用、转载需注明出处，且不得对本报告进行有悖原意的引用和修改。

本研究报告仅供北京研精毕智信息咨询有限公司客户和经本公司授权机构的客户使用，未经授权私自刊载的机构以及其阅读和使用者应慎重使用报告，本公司不承担由此所产生的相关风险和责任。